

研究開発活動



TDKグループの研究開発活動は、多様化するエレクトロニクス分野へ対応すべく新製品開発の強化拡大に引き続き努め、特に、次世代記録関連製品、移動体通信関連のマイクロエレクトロニクスモジュールや、素材技術と設計技術を基盤とし省エネルギーと環境に配慮したデバイスの研究開発に注力してきました。また、技術資源を情報家電、高速大容量ネットワーク、カーエレクトロニクスの3分野へ集中し、効率的な研究開発に取り組んでいます。

電子素材部品分野ではコア技術を活かした薄膜コモンモードフィルタ等超小型部品への対応、記録デバイス分野ではモバイル向けHDD用220Gbps級PMRヘッドの製品化、記録メディア製品分野では大容量(二層50GB) Rewritableブルーレイディスクの製品化等、次世代DVD関連製品の強化を進めました。また、積層チップバリスタやチップEMIフィルタアレイ等のEMC対策部品の製品化も強化しています。

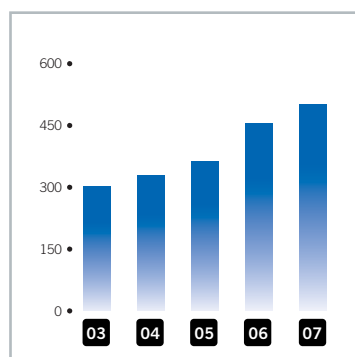
TDKの開発体制は、基礎材料開発センター、プロセス技術開発センター、デバイス開発センター、生産技術開発センター、素材解

析センター、アプリケーションセンターSQ研究所及び各事業部門の技術開発機能からなり、それぞれの担当領域の新製品、新技術開発を推進しています。アプリケーションセンターは、市場動向、顧客ニーズへの感度を高めるべく、応用技術への対応を目指しています。基礎材料開発センターは主として粉体材料技術を用いた磁性体・誘電体材料を、プロセス技術開発センターは先端プロセス技術への対応を、デバイス開発センターは新規デバイス開発を担当しています。

海外研究開発活動としては、米国、欧州の有力大学との研究開発の推進、海外研究開発子会社による現地技術資源の活用強化等があげられます。今後の事業基盤の確立と展開を目指す中国においても、電子部品材料関連の研究開発活動を行っています。その他連結子会社の研究開発活動としては、Headway Technologies, Inc. における次世代HDD用ヘッドの開発を引き続き推進しています。

なお、2007年3月期の研究開発費は、前期比9.9%増の50,058百万円(売上高比5.8%)です。

研究開発費
(億円)



売上高比率
(%)

